

レーザー開封装置

FALIT

レーザー及びレーザー加工分野で50年以上の歴史を持つコントロールレーザー社(CLC)は、世界で初めてレーザー開封装置の販売を開始しました。業界のリーディングカンパニーであるCLCがお届けする半導体ICパッケージへのレーザー開封装置です。

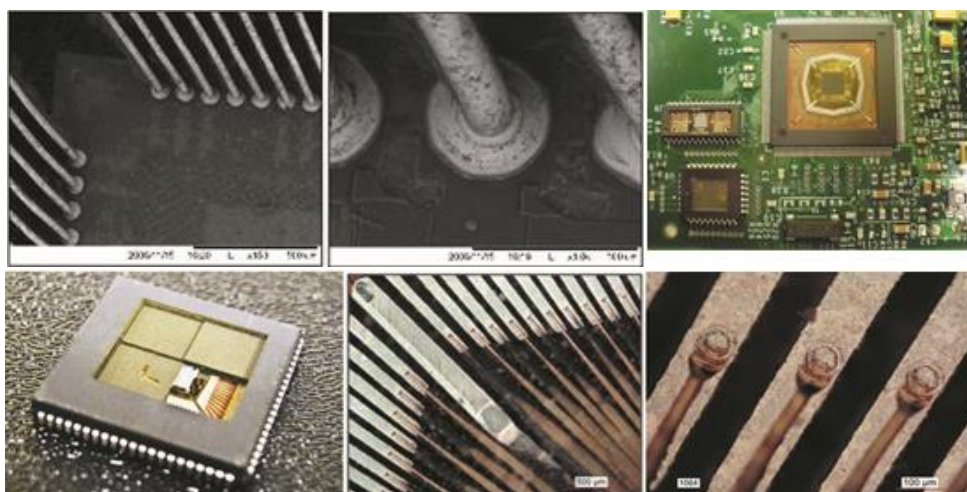


主な特徴

- ・モニター画面で確認しながら多種の加工形状にてサイズ及び位置を設定可能
- ・モニター画面上で観察しながら加工可能
- ・IGBT やパワーデバイス等のフィラー含有率の高い固いモールドも開封可能
- ・Cu, Au ワイヤの IC もワイヤーへのダメージは最小限で開封可能
- ・光学12倍ズームの搭載により高い位置精度で加工可能
- ・レーザーのメンテナンスはフリー

レーザー開封特許取得済

米国特許番号 7,271,012
 日本特許番号 4,843,488
 中国特許番号 ZL200480022971.0
 フィリピン特許番号 1-2006-500131
 EU 特許申請番号 04778639.7 (審査中)
 カナダ特許申請番号 2,532,959 (審査中)
 韓国特許申請番号 10-2006-7000841 (審査中)

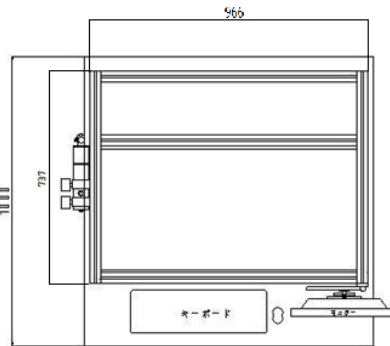
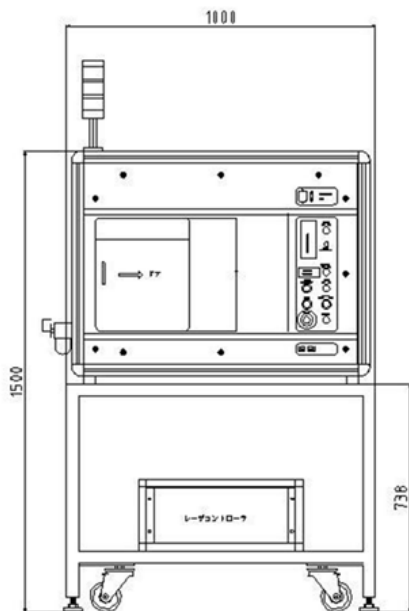
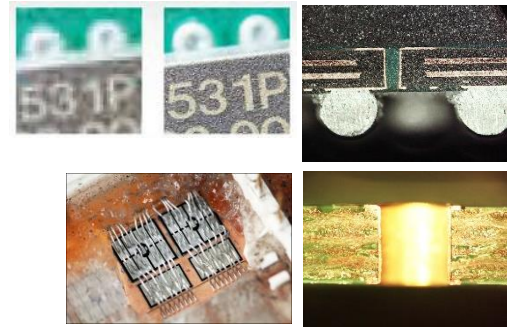


IC パッケージ開封装置 FALIT with Digital ICO モジュール仕様		
形式		FALIT
レーザ	出力	20W
	波長	1,064nm
最大加工エリア		約 48mm x 36mm
最小加工エリア		約 4.3mm x 3.4mm
電動 Z 軸ステージ		75mm
光学レンズ倍率		12X
ズーム機能		10 段階
PC	OS	Windows 7/10 (英語版)
	ソフトウェア	Failure Analysis Pro
	モニター	20 インチ
ユーティリティ	電源	AC100V 15A 50/60Hz
	圧縮空気	0.5MPa 250 ℓ /min
装置サイズ(本体)		966(W) x 737(D) x 770(H)
装置重量		約 150Kg


装置、集塵機仕様及び寸法は予告なく変更する場合があります。

オプション

- ・専用架台(必須)
- ・集塵機(必須)
- ・切断(CrossSection)対応機能
- ・透明樹脂(Gel)対応機能
- ・レーザパワーメータ
- ・コールドプレート、クールブラスト
- ・高解像度カメラシステム、
- ・インテリジェントビジョンシステム
- ・マニュアル X-Y ステージ等



FALIT での加工動画

 クラス1レーザ製品

本体とコントローラは取り外し出来ないケーブルで接続されております。

FALIT 全体図 (1,000(W)x1,000(D)x1,500mm(H))